

证券代码：001269  
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技  
债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-012

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司

### 关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧晶科技”）于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募投项目，拟从原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”中调出募集资金10,040.90万元人民币，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”，本次变更部分募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保荐人就该事项发表了明确的同意意见，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币470,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币7,259,688.67元，实际募集资金净额为人民币462,740,311.33元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字〔2023〕281189号）《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。

##### （二）原募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
1	宁夏石英坩埚一期项目	7,612.58	4,443.79
2	宁夏石英坩埚二期项目	25,288.42	-
3	补充流动资金项目	13,373.03	13,373.03
合计		<b>46,274.03</b>	<b>17,816.82</b>

注：1、以上数据未经审计。

2、光伏行业承受供需错配、竞争加剧、产品持续跌价、行业整体开工率不高等压力，行业整体盈利持续承压。公司结合市场环境和发展规划审慎评估，为确保募集资金投入有效性，避免大额固定资产投资对公司资金的占用，更好地适应光伏行业周期性波动，基于谨慎性原则，暂未实施“宁夏石英坩埚二期项目”。

### （三）本次募集资金用途变更情况

根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募投项目，从原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”建设，占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额的 21.36%。

本次变更前后募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	分类	承诺募集资金投资项目	实施主体	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	原募投项目	宁夏石英坩埚一期项目	宁夏欧晶科技有限公司	7,612.58	7,612.58
2		宁夏石英坩埚二期项目	宁夏欧晶科技有限公司	25,288.42	15,247.52
3		补充流动资金项目	内蒙古欧晶科技股份有限公司	13,373.03	13,373.03
4	新增募投项目	半导体石英坩埚建设项目	内蒙古欧晶科技股份有限公司	0.00	10,040.90
合计				<b>46,274.03</b>	<b>46,274.03</b>

#### **（四）本次新增募投项目审批及备案情况**

新增募集资金投资项目已完成在主管部门的备案程序，目前正在办理环评手续，公司将督促相关部门尽快完成各项审批。

#### **二、本次变更部分募投项目投资金额、新增募投项目原因**

近年来，我国半导体产业快速发展，根据 Gartner 数据，2024 年全球半导体市场规模达 6,260 亿美元，同比增长 18.1%。随着 5G、人工智能、物联网等新兴领域的崛起，半导体硅片领域对高性能、高纯度石英坩埚的需求持续增加。与此同时，随着国内晶圆制造和硅片厂商的崛起，也进一步推动了国内下游企业对半导体石英坩埚的市场需求，为国内自主生产提供了广阔空间。公司结合未来发展规划，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，经公司审慎评估后，明确在使用募集资金总额不变的前提下，公司拟调整部分募投项目投资金额、新增募投项目和实施主体，一方面项目建设有助于提升半导体坩埚在产品结构中的占比，分散行业风险，另一方面将现有厂房改造为高标准的半导体石英坩埚生产车间，通过引进国内外先进设备，持续提升坩埚纯度及尺寸，响应下游半导体硅片向大直径、控缺陷、精抛光、少杂质发展的技术趋势。项目的实施，公司的半导体石英坩埚产能将实现进一步扩充，有助于巩固公司行业地位。

#### **三、新增募投项目基本情况**

##### **（一）项目基本情况和投资计划**

- 1、项目名称：半导体石英坩埚建设项目
- 2、项目实施主体：内蒙古欧晶科技股份有限公司
- 3、项目实施地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
- 4、项目建设周期：24 个月
- 5、项目投资金额：11,701.95 万元

6、新增项目建设内容：项目拟将现有厂房改造为半导体石英坩埚车间。预计项目建成后，公司将具备年产 2.6 万只半导体石英坩埚的生产能力，公司产品结构和产品体系将得到进一步优化和完善，综合竞争力将得到显著提升。

7、项目投资总额 11,701.95 万元，计划使用募集资金金额 10,040.90 万元，项目资金不足部分公司将通过自有或自筹资金解决。

项目投资计划如下：

单位：万元

序号	投资构成	投资总额	募集资金投入金额
1	工程及设备费用	10,066.50	10,040.90
1.1	建筑工程费	2,160.60	2,135.00
1.2	工程建设其他费用	196.00	196.00
1.3	设备购置及安装费	7,709.90	7,709.90
2	预备费	503.33	0.00
3	铺底流动资金	1,132.13	0.00
	合计	11,701.95	10,040.90

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## （二）项目的必要性分析

### 1、项目建设有助于公司提升半导体坩埚产品结构占比，分散行业风险

目前公司营业收入构成中光伏领域占比较大，近两年来，受下游光伏市场周期性需求变化，公司业绩随之出现一定程度的波动。为平滑下游市场波动带来的影响，公司亟需加大对半导体石英坩埚领域的投入。本项目依托公司多年积累的石英坩埚生产经验及技术，引进技术团队，加大研发投入，改进生产工艺，持续提升半导体用石英坩埚生产线自动化水平，不断完善生产管理体系。项目建成后，公司半导体石英坩埚的制造水平及产能将得到较大的提升，通过提升半导体坩埚在产品结构中的占比，为公司分散行业风险奠定坚实的基础。

### 2、项目建设是实现高端半导体石英坩埚国内自主生产的必要选择

在中低端半导体石英坩埚领域，经过多年的发展，我国企业已基本实现 18 英寸及以下半导体石英坩埚的国内自主生产，且部分企业已实现 24-28 英寸坩埚的量产；但在 32 英寸及以上大尺寸半导体石英坩埚领域，高端石英坩埚供给仍以海外企业为主，国家已将产业链技术安全提上日程，中高端半导体石英坩埚的国内自主生产迫在眉睫。在此情况下，公司亟需加强对半导体高端石英坩埚的研发投入，进一步加大公司在半导体石英坩埚厂房设施、生产设备及技术人才方面的投入力度，借助公司多年积累的技术、研发和产品优势，持续提高半导体坩埚的生产质量，为实现中高端半导体石英坩埚国内自主生产创造条件。

### 3、项目建设是抢占下游市场份额，巩固公司行业地位的需要

近几年，在半导体产业下游需求快速增长的背景下，全球半导体硅片出货量连续多年稳步增长，根据 SEMI 的数据显示，全球半导体硅片出货面积已从 2019 年的 118.1 亿平方英寸增长至 2023 年的 157.0 亿平方英寸，年复合增长率达到约 7.3%；国内方面，受益于国内自主生产，中国半导体硅片出货面积从 2019 年的 12.0 亿平方英寸增长至 2023 年的 23.9 亿平方英寸，年复合增长率高达 18.8%，预计未来随着我国半导体硅片国内自主生产进程的持续推进，我国半导体硅片市场规模有望持续保持高速增长态势。在此背景下，为积极响应下游市场需求，公司拟利用现有厂房改造为高标准的半导体石英坩埚生产车间，并通过引进国内外先进设备的方式，持续提升坩埚纯度及尺寸，以响应下游半导体硅片向大直径、控缺陷、精抛光、少杂质发展的技术趋势。通过本项目的实施，公司的半导体石英坩埚产能将实现进一步扩充，有助于公司抢占下游市场份额，巩固公司行业地位。

### （三）项目的可行性分析

#### 1、下游市场需求的快速增长为产能消化提供保障

近年来，我国半导体产业快速发展，根据 Gartner 数据，2024 年全球半导体市场规模达 6,260 亿美元，同比增长 18.1%。随着 5G、人工智能、物联网等新兴领域的崛起，半导体硅片领域对高性能、高纯度石英坩埚的需求持续增加。与此同时，随着国内晶圆制造和硅片厂商的崛起，也进一步推动了国内下游企业对半导体石英坩埚的市场需求，为国内自主生产提供了广阔空间。下游市场的巨大增长潜力为本项目建设提供了良好的市场条件，为项目产能消化提供有力的市场保障。

#### 2、半导体及新材料产业政策推动行业技术进步

半导体产业作为国家战略性新兴产业，其快速发展推动对上游石英坩埚需求的增长。近年来，政府出台了一系列涵盖石英坩埚细分领域的半导体产业支持政策，以促进行业健康发展。2019 年，《产业结构调整指导目录》将“高纯石英原料、半导体用高端石英坩埚”等列为鼓励类发展产业。2021 年，《重点新材料首批次应用示范指导目录》将“半导体用高纯石英玻璃制品”列入目录，明确高纯石英制品属于重点新材料。此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四

个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、装备材料等研发突破与迭代应用。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策（国发〔2020〕8 号）》强调聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具等领域的关键核心技术研发，持续探索关键核心技术攻关。国家政策的出台有力推动了半导体石英坩埚产业的技术和产业升级。

### 3、丰富的技术及工艺积累和完善的质控体系为项目顺利实施打下基础

自成立以来，公司专注于石英制品业务，通过多年核心技术和工艺的积累，掌握了涵盖石英坩埚产品成型、熔制、检验、喷砂、酸洗、清洗、烘干、喷涂、封装等在内的多项核心技术，实现全生产链条专利技术覆盖，在高品质、大尺寸石英坩埚制造领域具有显著的竞争优势。在多年的生产运营经验基础上，公司制定了完善的质量管理制度，从源头把控原材料纯度，对材料、制程、检验、包装出厂等每一个生产环节设定标准规范的质量控制制度，以及不断进行产品研发和技术提升以确保产品质量。凭借多年在石英坩埚行业的技术积累，公司先后被认定为国家级专精特新小巨人企业、内蒙古自治区知识产权优势企业、呼和浩特市科技领军企业并获得了内蒙古品牌建设促进会的“内蒙古百强品牌”荣誉，连续两届被中国电子材料行业协会评为“中国电子材料行业石英材料专业十强企业”。与此同时，公司在石英坩埚领域市场份额及认可度较高，与中环领先、有研半导体等生产商建立了长期、稳定的合作关系，为本项目顺利实施打下了坚实基础。

## （四）新增募投项目的风险

### 1、市场竞争风险

随着半导体产业链各环节国内自主生产趋势的延续，部分同行业公司正在加速在石英坩埚领域的产能布局，随着未来半导体石英坩埚行业新进入者及新建产能增多，现有行业参与者面临的市场竞争可能进一步加剧。在此背景下，如果公司不能及时研发出适应技术发展和工艺更新的产品，可能面临失去订单或客户的风险，从而对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

### 2、原材料价格波动风险

石英坩埚生产企业采购的原材料主要为高纯度石英砂。目前全球能够批量供应高等级太阳能及半导体用高纯石英砂的企业较少，矽比科公司和 TQC 在行业中

处于垄断地位。为提高产品的质量，满足国内中高端客户的需求，公司多年以来向矽比科公司采购石英砂原料。由于石英坩埚成本结构中原材料成本占较大比例，因此其采购价格的变化是导致企业毛利率波动的重要因素。但由于上述两家供应商高度垄断且供给量相对有限，未来进口砂价格可能会出现超出市场预期的大幅波动，从而对本项目盈利能力产生影响。此外，如果国产高纯石英砂取得技术突破且可替代进口砂，行业的供需关系及价格逻辑也将出现变化。

### 3、产品质量风险

本项目产品为半导体级石英坩埚，由于产品应用领域的特殊性，坩埚的纯度将在很大程度上影响着下游产品品质，并对下游客户生产产生直接影响。产品质量事故所造成的影响和损害将对公司带来严重的不良影响。尽管公司拥有完善的质量控制规程，但仍不能完全杜绝因控制失误、责任人疏忽、过程衔接有误等因素，导致石英坩埚及相关配套产品质量受影响的情形出现。

### 4、技术风险

公司为技术、知识密集型的高新技术企业，拥有较多知识产权与核心非专利技术，多项核心工艺、技术为行业创新，达到国内领先水平，这些核心工艺、技术都是公司核心竞争力的重要组成部分，是公司竞争优势的具体体现。但高新技术及产品的研发在很大程度上需要依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果公司出现核心技术人员流失或技术人员私自泄露公司技术机密的情形，不仅会影响公司的持续技术创新能力、而且会导致技术泄密，严重影响公司的生产经营。

## （五）项目经济效益分析

经预测分析，本项目税后静态投资回收期（含建设期）为 7.20 年，税后内部收益率为 17.89%。本项目的经济效益指标合理，经济效益方面切实可行。上述经济效益分析基于公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出，不构成对公司未来业绩的承诺。

## （六）募集资金管理计划

为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟增设募集资金专户，用于新增项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司

将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

#### **四、本次变更部分募投项目、新增募投项目对公司的影响**

本次变更部分募投项目以实施新增募投项目，是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司核心技术研发的突破，有利于长远健康发展。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司制度，科学、合理决策，加强对项目建设进度的监督，确保项目按计划进行建设。

#### **五、公司履行的审议程序及相关意见**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额25,288.42万元中调出募集资金10,040.90万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”，并提交公司股东大会审议通过后实施。

##### **（二）监事会审议情况**

公司于2025年3月19日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目是基于公司综合考虑了市场、行业环境变化及公司实际经营情况作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的要求；本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，有利于公司相关固定资产投资项目的顺利实施和推进，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未

来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司监事会一致同意该议案，并提交公司股东大会审议通过后实施。

### **（三）独立董事专门会议意见**

公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目是根据公司实际经营发展需要和战略规划，结合市场趋势与公司客观情况作出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定。全体独立董事一致同意该议案。

### **（四）保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的事宜已经公司董事会审议批准，监事会发表明确同意意见，除尚需股东大会审议外，公司已履行了必要的内部审批程序。该事项是公司依据整体发展战略等因素作出的决策，有利于提高募集资金使用效率、维护全体股东利益并满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。保荐人对于公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1、内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的核查意见》；
- 5、新增募集资金投资项目的可行性研究报告。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年3月19日